PCB 焊接工艺要求	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
	直流伺服	MGRD-2408(12)SMAO_CON_V2.1	焊接	QM03320090802	V2.1	1/1	20200908

焊接基本要求

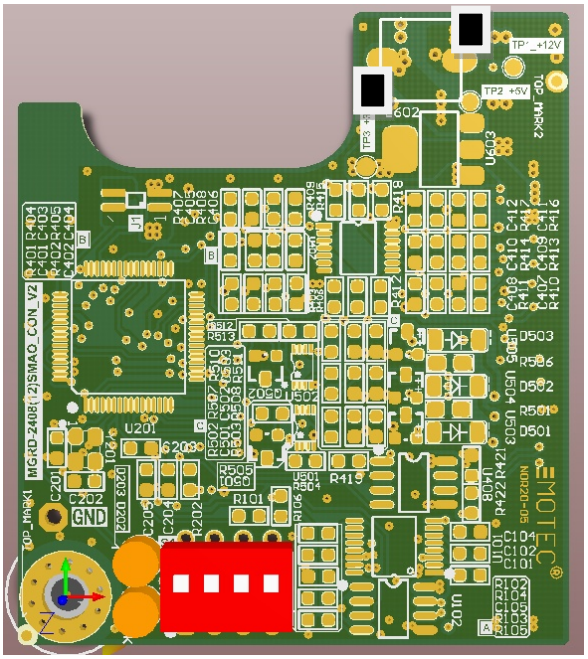

图 1

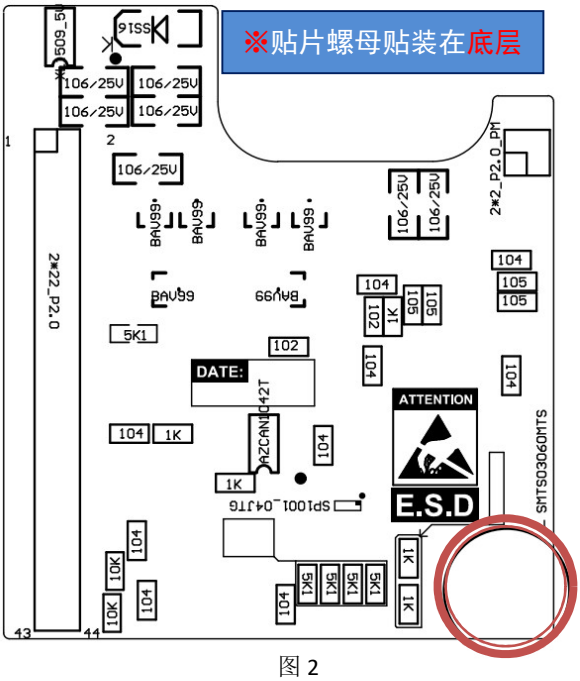

图 2

1) 顶层电感 L602，按照图示的黑色区域，涂覆 704 黑色胶，粘接与线路板，胶的厚度要高于 1mm，不要拉丝；
2) 注意贴片螺母的型号，其中 LH5 位置焊接贴片螺母 SMTS03060MTS，
SMTS03060MTS（红色字符为高度：060 为 6mm 高）

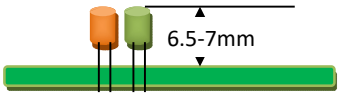

图 3

3) 红色及绿色 LED 插件指示灯焊接高度为 6.5-7mm（见图 3）
4) 排母居中，对齐中心位置焊接，XY 方向偏差小于 0.3mm，严禁浮高现象；
5) 所有端口插座焊接需要压到底焊接，不接受歪扭，偏差要小于 0.3mm；
6) 所有极性元件严禁方向反；
7) 不接受虚焊，空焊，焊锡短路；
8) 未特殊说明的元件，均紧贴线路板焊接；
9) 手工操作要做防静电处理；
10) 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准；
11) 贴装元件位置图详见焊接丝印图文件；

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	